



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105584680 A

(43) 申请公布日 2016. 05. 18

(21) 申请号 201610167223. 6

(22) 申请日 2016. 03. 23

(71) 申请人 苏州承乐电子科技有限公司

地址 215101 江苏省苏州市吴中区木渎镇珠
江南路 378 号天隆大楼 4720 室

(72) 发明人 顾燕萍

(74) 专利代理机构 南京正联知识产权代理有限
公司 32243

代理人 顾伯兴

(51) Int. Cl.

B65B 41/12(2006. 01)

B65B 47/02(2006. 01)

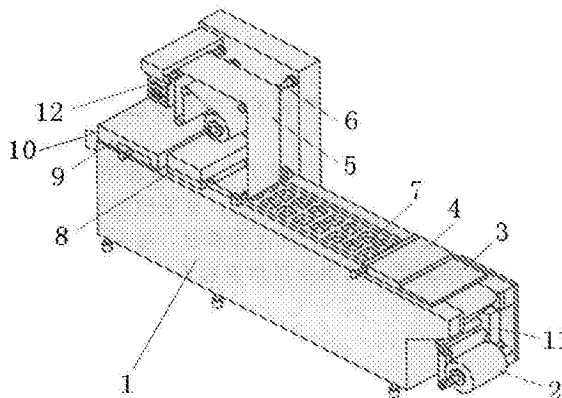
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

自动热成型包装机

(57) 摘要

本发明公开了一种自动热成型包装机,包括机架,所述机架的底部一侧设有底膜卷料筒,机架的上表面靠近底膜卷料筒的一端设有余热区和热成型区,机架的另一端上方安装有上膜机构,所述上膜机构上设有上膜引导装置,机架的上表面上安装有输送产品的输送链夹,所述输送链夹的一端设于余热区和热成型区的下方,另一端设于热风区和裁切区的下方,机架的另一端还设有一出料槽,本发明的自动热成型包装机结构简单,设计合理,包装效率高,且自动化程度高,能够降低工人劳动强度,适用范围广。



1. 一种自动热成型包装机,其特征在于:包括机架(1),所述机架(1)的底部一侧设有底膜卷料筒(2),机架(1)的上表面靠近底膜卷料筒(2)的一端设有余热区(3)和热成型区(4),机架(1)的另一端上方安装有上膜机构(5),所述上膜机构(5)上设有上膜引导装置(6),机架(1)的上表面上安装有输送产品的输送链夹(7),所述输送链夹(7)的一端设于余热区(3)和热成型区(4)的下方,另一端设于热风区(8)和裁切区(9)的下方,机架(1)的另一端还设有一出料槽(10)。

2. 根据权利要求1所述的自动热成型包装机,其特征在于:所述底膜卷料筒(2)的上方还设有一底膜导引装置(11)。

3. 根据权利要求1所述的自动热成型包装机,其特征在于:所述上膜机构(5)上还设有一控制器(12),用于控制和操作上膜机构(5)。

自动热成型包装机

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及包装技术领域,特别涉及一种自动热成型包装机。

背景技术

[0003] 包装机就是把产品包装起来机器,起着保护,美观的作用。热成型包装机是在加热条件下对热塑性片状包装材料进行深冲,形成包装容器,然后进行充填和封口的机器。在热成型包装机上能分别完成包装容器的热成型/包装物料的充填(定量)、包装封口、裁切、修整等工序。而现有的热成型包装机包装效率差,结构复杂,加工成本较高,且包装容错率低,影响包装质量。

[0004]

发明内容

[0005] 为了克服上述缺陷,本发明提供了一种能够解决上述问题的自动热成型包装机。

[0006] 本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种自动热成型包装机,包括机架,所述机架的底部一侧设有底膜卷料筒,机架的上表面靠近底膜卷料筒的一端设有余热区和热成型区,机架的另一端上方安装有上膜机构,所述上膜机构上设有上膜引导装置,机架的上表面上安装有输送产品的输送链夹,所述输送链夹的一端设于余热区和热成型区的下方,另一端设于热风区和裁切区的下方,机架的另一端还设有一出料槽。

[0007] 作为本发明的进一步改进,所述底膜卷料筒的上方还设有一底膜导引装置。

[0008] 作为本发明的进一步改进,所述上膜机构上还设有一控制器,用于控制和操作上膜机构。

[0009] 本发明的有益效果是:本发明的自动热成型包装机结构简单,设计合理,包装效率高,且自动化程度高,能够降低工人劳动强度,适用范围广。

[0010]

附图说明

[0011] 图1为本发明结构示意图;

图中标示:1-机架;2-底膜卷料筒;3-余热区;4-热成型区;5-上膜机构;6-上膜引导装置;7-输送链夹;8-热风区;9-裁切区;10-出料槽;11-底膜导引装置;12-控制器。

[0012]

具体实施方式

[0013] 为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。

[0014] 图1示出了本发明一种自动热成型包装机的一种实施方式,包括机架1,所述机架1

的底部一侧设有底膜卷料筒2,机架1的上表面靠近底膜卷料筒2的一端设有余热区3和热成型区4,机架1的另一端上方安装有上膜机构5,所述上膜机构5上设有上膜引导装置6,机架1的上表面上安装有输送产品的输送链夹7,所述输送链夹7的一端设于余热区3和热成型区4的下方,另一端设于热风区8和裁切区9的下方,机架1的另一端还设有一出料槽10。所述底膜卷料筒2的上方还设有一底膜导引装置11。所述上膜机构5上还设有一控制器12,用于控制和操作上膜机构5。

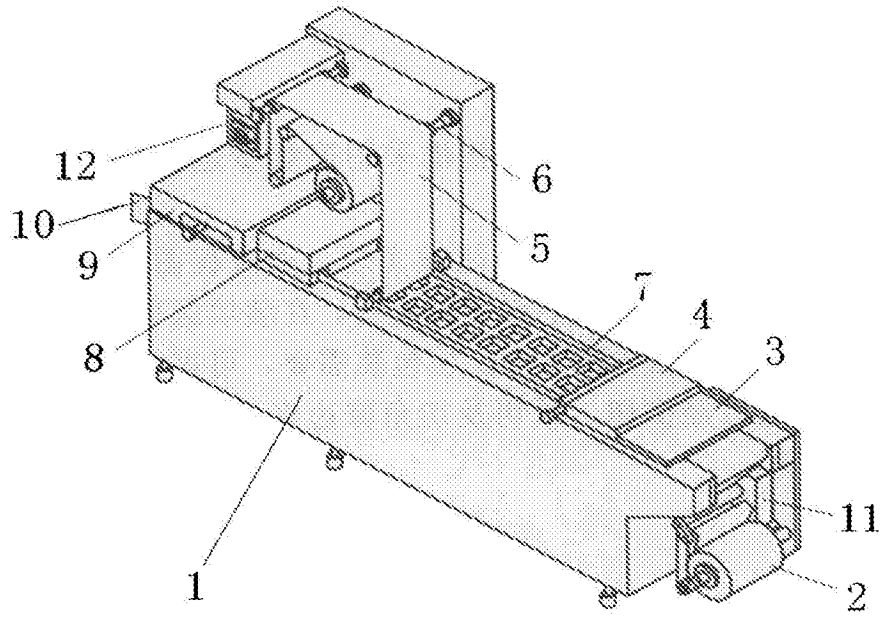


图1